



苏州电路板展览会



苏州半导体/光电/表面贴装展览会

2006 年 4 月 19-21 日苏州国际博览中心圆满闭幕

2006 苏州 PCB 暨半导体/光电/表面贴装展览会 4 月 19 日(三)至 21 日(五)于苏州国际博览中心圆满闭幕。此次展览博得参展厂商与专业观众在展览规划上专业、效率与灵活应用的美誉,而展出现场所激荡出来的丰沛商机,也证明了苏州 PCB 展览会无疑是全球电路板与组装产业的新舞台与全球采购商不愿错过的采购胜地。

今年应邀剪彩的来宾共计 10 位代表出席剪彩仪式:

海峡经济科技合作中心	策划部部长袁寒冰先生
沪士电子(昆山)有限公司	总裁 吴礼淦先生
上海展华电子有限公司	执行董事(华东 PCB 联谊会会长) 陈正雄先生
鑫华宝讯电子有限公司	总经理(华南 PCB 联谊会会长) 陈明星先生
百硕计算机(苏州)有限公司	总经理 林清培先生
南亚电路板(昆山)有限公司	执行副总 汤安得先生
翔国计算机(苏州)有限公司	董事长 赖国恩先生
雅新电子(苏州)有限公司	总经理 卢耀普先生
敬鹏(苏州)电子有限公司	副总经理 杨其筠先生
嘉联益科技股份有限公司	总经理 吴永辉先生

参展规模历年最大!

2006 年是个值得我们庆贺的一年,不但全球市场经济明显回升。同时苏州 PCB 展览会更胜以往规模,我们拥有了 820 个摊位(总展示面积达 15,000 平米),同时集合了全球 252 家参展厂商,这样的展示规模更使得苏州 PCB 展览会位于华东地区更具有代表性。参展三天共计有 13,086 位贵宾莅临参观。以参展领域占比来看,PCB 展商 57%; 电子组装: 9%; 半导体: 10%; 光电: 11%; 电子产品代工: 7%; 其它: 4%; 学术单位: 2%。

活动总览

名称	苏州电路板展览会 Suzhou PCB Show (CTEX2006) 苏州半导体/光电/表面贴装展览会 Suzhou Semiconductor/OPTO/SMT Show(ETEX2006)				
主办单位	海峡经济科技合作中心				
协办单位	台湾电路板协会(TPCA)				
办理单位	苏州剑桥展览商务有限公司 香港讯通展览公司 台湾展昭国际企业股份有限公司				
合作单位	台北市计算机商业同业公会 台湾经济日报				
会期	进场时间: 4/16(日)~18(二)08:30-20:00 展览期间: 4/19(三)~4/21(五)09:30-17:00 退场期间: 4/22(六)08:30-18:00				
会场	苏州国际博览中心(15,000 平米)				
厂商数	252 家				
摊位数	820 个摊位(每个摊位面积=3m X 3m)				
参观人数	13,086 人				
主题活动	内容	日期	时间	地点	展位编号
	技术研讨会	4/19-21	09:30-17:00	3A 馆	3F 会议室
	VIP Lounge	4/19-21	09:30-17:00	4A 馆	AZ20
	Coffee Shop	4/19-21	09:30-17:00	4A 馆	AU20
	PCB 专业书城	4/19-21	09:30-17:00	4A 馆	BG3
	华东 PCB 产业高峰 联谊餐叙	4/19	12:00-14:00	3A 馆 3F	蓝枪鱼餐厅
	表面贴装技术主 题展示区	4/19-21	09:30-17:00	4A 馆	BH18
	PCB 检测设备与技 术主题展示区	4/19-21	09:30-17:00	4A 馆	AH18
	新产品发表会	4/19-21	09:30-17:00	3A 馆	3F 会议室
	网络服务区	4/19-21	09:30-17:00	4A 馆	BG3
	会场寻宝游戏	4/19-21	09:30-17:00	3A+4A	B5, AB7, BG17
	高尔夫球联谊赛	4/18	11:30-19:00	苏州三阳球场	
接送班车服务	4/19-21	08:00-18:00	展馆-昆山 展馆-苏州酒店 展馆-火车站		

协力单位

(a)水电气、装潢搭建工程

台湾—辉佑实业有限公司

电话: 886-2-26686979;传真: 886-2-26685919

地址: 台北县板桥市万板路 192 号 14 楼之 3

连络人: 王璇智先生;E-mail: kimberly@ishowl68.com.tw

大陆—上海捷恩斯企业形象策划有限公司

电话: 86-21-62918083;传真: 86-21-62918093

地址: 上海市长宁区天山路 183 号 3 楼 306 室

连络人: 杨圣乙先生;E-mail: sales@zions-x.com.cn

(b)报关、装运商(现场堆高机装运工程)

台湾—海湾国际股份有限公司

电话: +886-2-27467621;传真: +886-2-27467622

地址: 台北市民生东路五段 165 号 4 楼之 4

电邮: exhibition@crownavan.com

连络人: 黄世政先生、曾萌燕小姐

大陆—国际展品的运输

(1)运展物流有限公司

电话: +852-28330106/13901034017;传真: +852-28346337

联络人: 杨世雄先生;E-mail: globalservice@exhibitstrans.com

(2)运展物流有限公司北京代表处

电话: +86-10-65615552;传真: +86-10-65614130

联络人: 李颂先生;E-mail: etbj@exhibitstrans.com

国内展品的运输

运展物流有限公司上海代表处

电话: +86-21-62280082;传真: +86-21-62293933

联络人: 石松涛先生;E-mail: etshanghai@exhibitstrans.com

(C)住宿/旅馆

昆山

裕元酒店 TEL:0512-57373688;FAX:0512-57353518

君豪酒店 TEL:0512-55062458;FAX:0512-57168825

苏州

苏州锦地星座大酒店 TEL:0512-65229188;FAX:0512-65229318

苏州人家大酒店 TEL:0512-67778888;FAX:0512-67779999

苏州凯莱大酒店 TEL:0512-65218855;FAX:0512-65238804

和乔丽晶公寓酒店 TEL:0512-68011118;FAX:0512-68011119

苏州书香门第商务酒店 TEL:0512-67635888;FAX:0512-67630777

苏州尼盛万丽酒店 TEL:0512-67618888;FAX:0512-67672131

中茵皇冠假日酒店 TEL:0512-67616688;FAX:0512-67611231

开幕仪式

时间	4/19(三) 09:00-09:30
地点	苏州国际博览中心 3A 馆前
剪彩贵宾	国务院台湾事务办公室海峡经济科技合作中心 策划部部长袁塞冰先生 沪士电子(昆山)有限公司 总裁 吴礼淦先生 上海展华电子有限公司 执行董事(华东 PCB 联谊会 会长) 陈正雄先生 鑫华宝讯电子有限公司 总经理(华南 PCB 联谊会会长) 陈明星先生 百硕计算机(苏州)有限公司 总经理 林清培先生 南亚电路板(昆山)有限公司 执行副总 汤安得先生 翔国计算机(苏州)有限公司 董事长 赖国恩先生 雅新电子(苏州)有限公司 总经理 卢耀普先生 敬鹏(苏州)电子有限公司 副总经理 杨其筠先生 嘉联益科技股份有限公司 总经理 吴永辉先生
司仪	展昭公司锤佳涵小姐
开场表演	模特儿表演现代舞蹈
致词代表	国务院台湾事务办公室海峡经济科技合作中心 策划部部长袁塞冰先生 上海展华电子有限公司 执行董事(华东 PCB 联谊会 会长) 陈正雄先生



欢迎晚宴

时间	4/19(三)17:00-18:30
地点	苏州国际博览中心 3A 馆与 4A 馆交界处
致词代表	展昭公司总经理林茂廷先生
表演	舞蹈表演、魔术表演、四川变脸表演、小丑表演 展昭林茂廷总经理现场演唱

为了让参展厂商能稍为放松心情，主办单位在开展第一天(4/19)下午 5 点举办欢迎酒会(Welcome Cocktail)。现场除了自助餐免费供应外，活动中并邀请到苏州知名爵士乐、活力竞舞、杂耍、四川变脸等精彩的表演，舒缓展商的压力；最后压轴由主理单位展昭国际企业(股)公司林总经理现场高歌后圆满结束。



新产品发表会

时间: 4/19-21;地点: 苏州国际博览中心三楼会议室

时间	4月19日		4月20日			4月21日	
10:00 10:40	安美特化学有限公司 ATOTECH ASIA PACIFIC LTD. 图形转移前铜面处理的先进工艺	日商荏原优莱特科技股份有限公司 EBARA-UDYLITE CO., LTD. 填孔硫酸铜电镀液之应用	日商荏原优莱特科技股份有限公司 EBARA-UDYLITE CO., LTD. 关于表面处理业界药液管理之现状与展望	安美特化学有限公司 ATOTECH ASIA PACIFIC LTD. 讲求环保的线路板生产趋势对除胶和传统沉铜的影响	台耀科技集团 TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION GROUP 无卤素材料: Hi-Tg 无卤素铜箔基板材料	安美特化学有限公司 ATOTECH ASIA PACIFIC LTD. 安美特环保型线路板生产系统	富士写真フィルム株式会社 FUJI PHOTO FILM CO., LTD. INPREX-富士胶片数码曝光系统
	Advanced Process for Cu Surface Treatment Before Image Transfer	Application of Acid Copper Plating Solution for Via Filling	Chemical Auto Control System Status and Perspective for Surface Finishing Area	Desmear and Plating Through Hole Considerations and Experiences for Green PCB Production	High Tg Halogen Free Copper Clad Laminate	Atotech's Systems for Green PCB Manufacturing	INPREX-Fuji Film's Digital Exposure Machine
11:00 11:40	安美特化学有限公司 ATOTECH ASIA PACIFIC LTD. 多层板生产的新概念	高顶机电(上海)有限公司 GOLDTEK COMPANY LIMITED 电子工业使用的高信赖与高性能合金	伊希特化股份有限公司 ROCKWOOD ELECTROCHEMICALS ASIA LTD. 直接金属化技术:去胶渣及直接电镀制程	安美特化学有限公司 ATOTECH ASIA PACIFIC LTD. 浸银的技术	罗门哈斯电子材料(东莞)有限公司上海分公司 ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS (DONGGUAN) LTD.SHANGHAI BRANCH 浸锡的槽液寿命与焊锡性	安美特化学有限公司 ATOTECH ASIA PACIFIC LTD. 研发液态感光抗蚀油墨用于精细线路科技的挑战	罗门哈斯电子材料(东莞)有限公司上海分公司 ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS (DONGGUAN) LTD.SHANGHAI BRANCH 填孔电镀技术 Copper Electroplating Technology for Microvia Filling
	New Concepts for The Production of HDI Printed Circuit Boards	High Reliability & Quality Solder Alloy for Electronic Industry	Desmear and Graphite Colloids Applied for Metalization.	Immersion Tin – Extended Testing for Lead Free Assembly	Understanding Shelf Life and Solderability of Immersion Tin	Circuitization, Imaging and Surface Preparation of FPCB	

时间	4月19日	4月20日	4月21日
13:00 13:40		<p>确信电子有限公司-乐思化学 COOKSON ELECTRONICS LIMITED-ENTHONE 微孔填充与通孔金属化同步的完全方案 A Complete Solution for Simultaneous Microvia Filling and Through-hole Metallization</p>	<p>爱克发有限公司 Agfa Limited</p> <p>爱克发新一代底片介绍 Agfa New Version Film (Idealine)</p>  
14:00 14:40	<p>伊希特化股份有限公司 ROCKWOOD ELECTROCHEMICALS ASIA LTD. 内层板处理技术：适用于Hi-Tg树脂压合之黑化及新棕化制程 The New Generation Oxide Replacement and Brown Oxide Treatment for High-Tg and Halogen-free Lamination</p>	<p>确信电子有限公司-乐思化学 COOKSON ELECTRONICS LIMITED-ENTHONE 适用于无铅制程的新一代耐高温OSP膜之性能及表征 The Characterization and Properties of a Newly Developed High Temperature Resistant OSP Coatings for Lead-free Processes</p>	<p>伊希特化股份有限公司 ROCKWOOD ELECTROCHEMICALS ASIA LTD. 电镀技术：高效能化铜及填孔电镀制程 High Performance PTH and Via Filling Technology.</p>  
15:00 15:40	<p>集华电子有限公司 CHAR TERMATE ELECTRONICS LTD. CharterSILVER377 新型微碱性化学银工艺 CharterSILVER377 New Weak Alkaline Immersion Silver Process</p>	<p>确信电子有限公司-乐思化学 COOKSON ELECTRONICS LIMITED-ENTHONE 新型沉银工艺的生产经验及特性 Production Experience and Performance Characterization of a Novel Immersion Silver</p>	<p>伊希特化股份有限公司 ROCKWOOD ELECTROCHEMICALS ASIA LTD. 无铅焊垫处理技术:第五代OSP及无黑垫之化学镍浸金制程 Lead-Free Final Finish Technology : The 5th Generation OSP & No black Pad ENIG.</p>  

参观来宾资料统计

参观人数：13,086 人

日期	人数
开展第一天 (4月19日)	5,236
开展第二天 (4月20日)	5,423
开展第三天 (4月21日)	2,427
总计	13,086

2006 与 2005 年参观者人数成长比较:

日期	2006 人数	2005 人数	成长率
开展第一天	5,236	2,627	99.3%
开展第二天	5,423	3,395	59.7%
开展第三天	2,427	1,105	119.6%
总计	13,086	7,127	83.6%

参展商国籍类别:

	陆资	台资	港资	德商	日韩	美商	其它外资	总计
厂商数	51	128	22	12	11	9	19	252
使用摊位	101	466	96	75	31	18	33	820

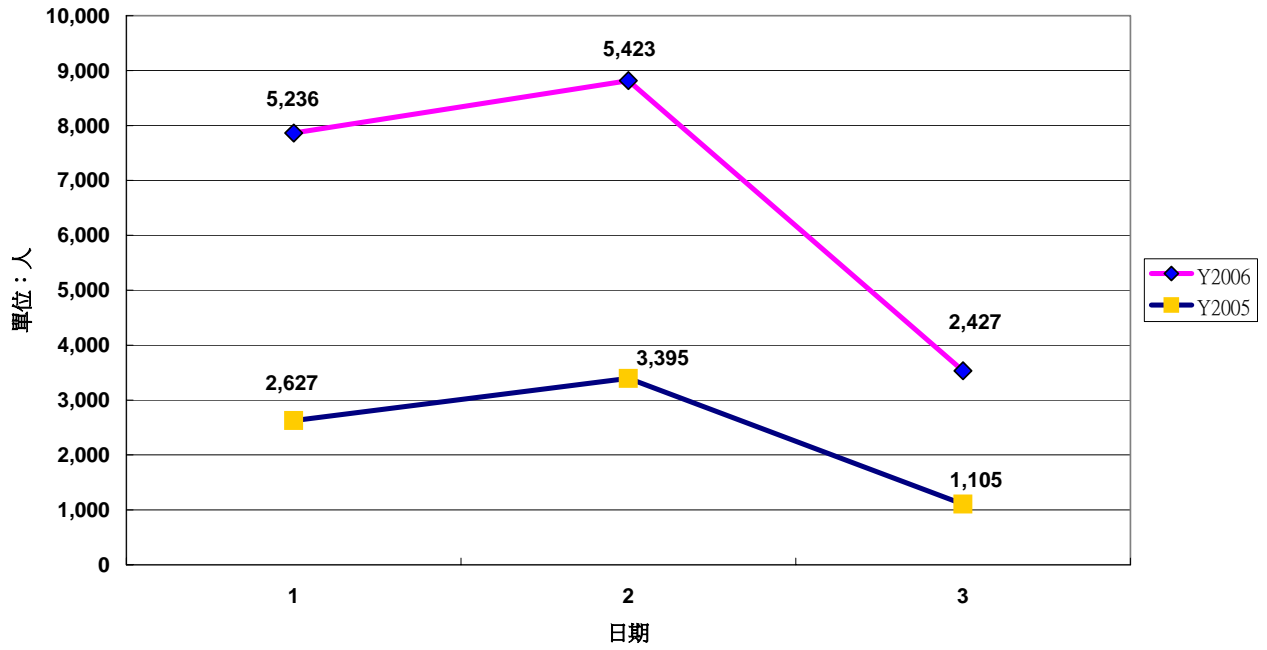
参展商陆、外资比例

国籍	厂商数	摊位数
台/港及其它外资企业(如:日韩/欧美等)	201	719
陆资企业	51	101
总计	252	820

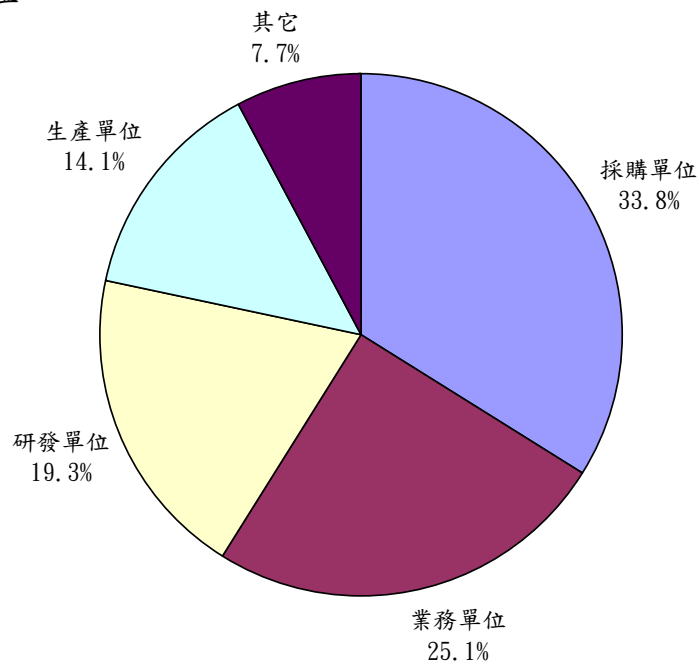
2006 与 2005 年厂商数与摊位数成长比较

年份	厂商数	摊位数
2006 年	252	820
2005 年	172	512
成长率	46.5%	60.2%

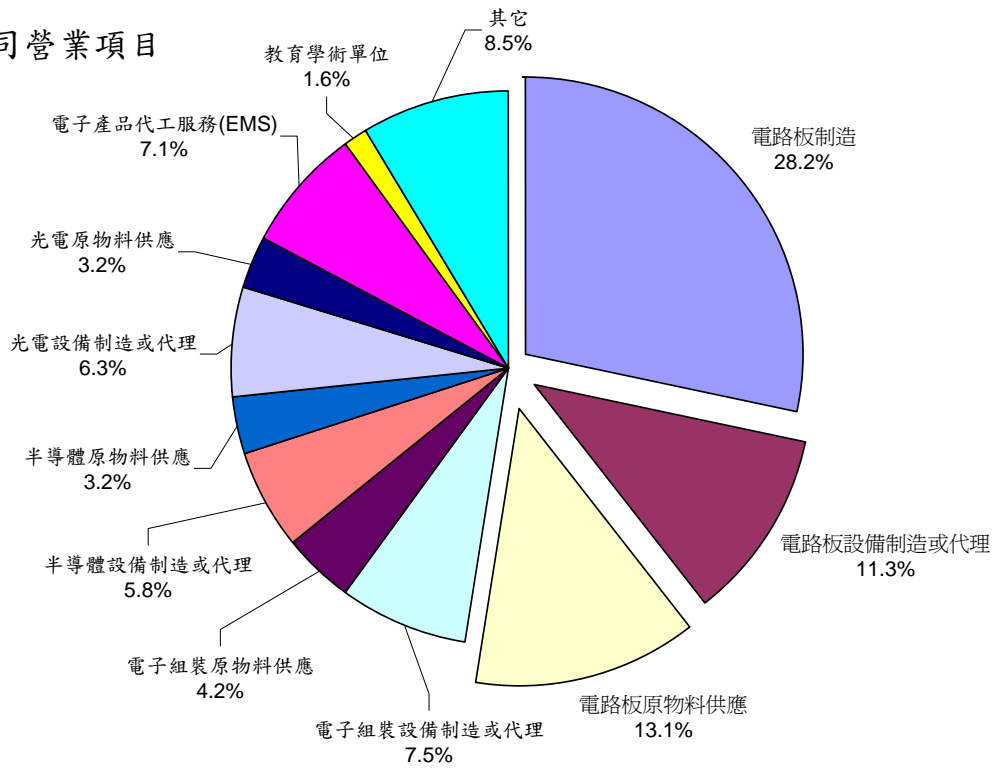
參觀人數比較圖(Y2005 V.S Y2006)



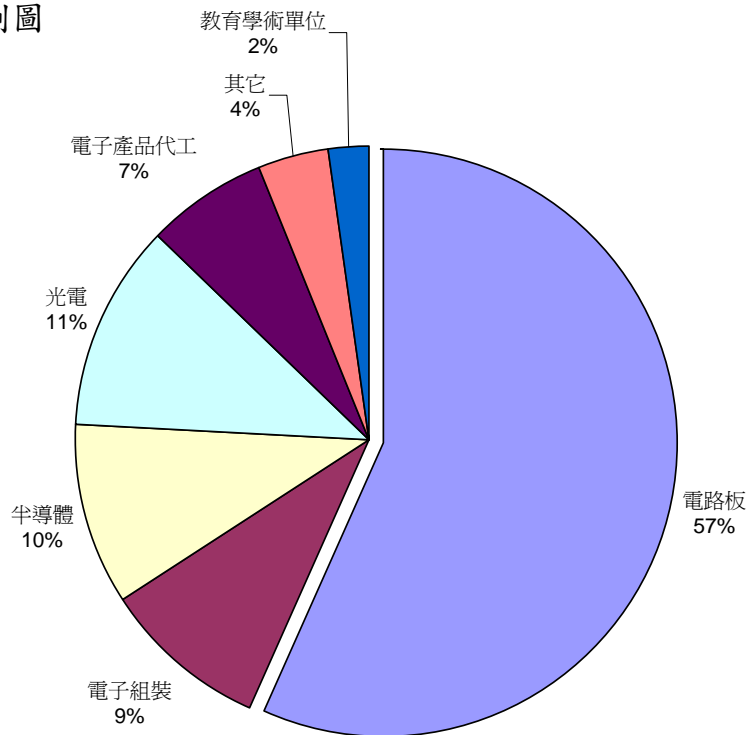
參觀來賓所屬單位



參觀來賓公司營業項目



展商展示產品比例圖



华东PCB产业高阶主管联谊餐叙

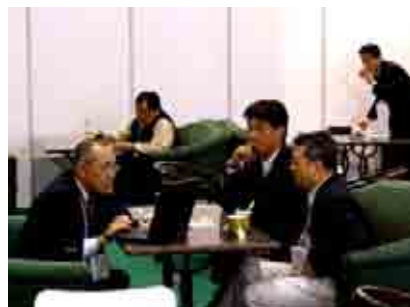
为了让华东电路板业者有机会齐聚一堂，主办单位特别设计了此次「午餐联谊会」邀请电路板厂及参展厂商进行交流，让大家在这一年一度的聚会里能够相互交换经验与想法。

1. 时间：4月19日中午12:00-14:00
2. 地点：苏州国际博览中心三楼蓝枪鱼餐厅



洽谈的世外桃源 VIP Lounge

在4A展览馆一角中，主办单位提供参展商洽谈而设计的一个专属休息室。此VIP Lounge中除提供美味茶点，让所有贵宾在此空间中可以轻松的洽谈或休憩，顺便逛逛摄影艺廊，可说是热闹展场内的世外桃源。



高尔夫球联谊

由华东 PCB 联谊会及华南 PCB 联谊会所主办，展昭国际企业(股)公司与台湾铜箔(股)公司赞助的 Suzhou PCB CUP 已于4月18日在苏州三阳高尔夫球场热闹开打，包含 PCB 业界各重要人士 100 余人共同参与；赛后由龙思祖(台湾上村化学)以 72.4 的优越成绩获得净杆冠军，净杆亚军为程肇明(超特国际)、净杆季军则由曾人哲(妙印精机)获得。球赛中并邀请日本、香港、两岸三地 PCB 来宾共组 7 队举办队际联谊赛(Suzhou PCB CUP Team)，赛后由台湾队拿下队际比赛团体冠军，亚军、季军则分别由大陆二队、大陆 I 队获得；台湾队队友程肇明(超特国际)更以优秀成绩荣获队际比赛最优秀选手(MVP)。活动赛事在中午 12 点 18 洞同时开球，赛后于 2 楼球场餐厅举行颁奖晚宴，场面热闹非凡。



电路板检测设备与技术主展示区

主办单位今年推出「电路板检测技术与设备展示区」，为业界首次将PCB检测技术具体呈现出来的创新展示主题。此专区邀集26家台湾制造或是代理PCB检测设备同业合力完成，内容从板材检测原理延伸至最终外观检查等检测技术等。从展示的内容可以发现，PCB检测技术已由传统人工检查，演进到自动化、非接触式以及光学检测，为符合PCB产品高精密度与高质量的需求，产业正朝向节省人力与提升量测精度的目标与技术开发努力，可以想见PCB检测技术的发展正在突飞猛进的成长中。

表面贴装技术主题展示区

在全球电子产品的环保法规要求下，加上电子产品轻薄与行动化设计的趋势，已影响相关零组件的组装技术都朝向表面贴装的方向上设计。为强调电路板与组装密不可分的发展，展览范畴延伸至电子组装技术，以呈现PCB暨组装的完整供应体系。因此今年推出「表面贴装SMT技术简介」主题专区，以丰富的图文呈现基础制程简介，完整概念让参观来宾能对于表面贴装技术有更具体的认识。



温馨接送情—接送车

昆山各酒店-展馆

昆山裕元酒店	昆山君豪酒店	展馆	昆山君豪酒店	昆山裕元酒店
08:20	08:35	09:35		
09:00	09:15	10:20		
10:00	10:15	11:20		
11:30	11:45	12:50		
		14:30	15:20	15:30
		15:30	16:20	16:30
		16:30	17:20	17:30
		17:30	18:30	18:50
		18:30	19:30	19:50

A. 路线一：苏州各酒店-展馆

苏州锦地星座大酒店	苏州人家大酒店	苏州凯莱大酒店	展馆	苏州人家大酒店	苏州锦地星座大酒店	苏州凯莱大酒店
08:40	08:50	09:00	09:30			
09:10	09:20	09:30	10:00			
09:40	09:50	10:00	10:30			
10:10	10:20	10:30	11:00			
10:40	10:50	11:00	11:30			
11:10	11:20	11:30	12:00			
			14:30	15:00	15:20	15:40
			15:00	15:30	15:50	16:10
			15:30	16:00	16:20	16:40
			16:00	16:30	16:50	17:10
			16:30	17:00	17:20	17:40
			17:00	17:30	17:50	18:10
			17:30	18:00	18:20	18:40
			18:00	18:30	18:50	19:10

B. 路线二：苏州各酒店-展馆

和乔丽晶公寓	书香门第商务酒店	尼盛万丽酒店	皇冠假日酒店	展馆	皇冠假日酒店	尼盛万丽酒店	书香门第商务酒店	和乔丽晶公寓
08:50	09:00	09:10	09:20	09:30				
09:30	09:40	09:50	10:00	10:10				
10:00	10:10	10:20	10:30	10:40				
10:30	10:40	10:50	11:00	11:10				
11:00	11:10	11:20	11:30	11:40				
11:30	11:40	11:50	12:00	12:10				
				14:30	14:40	14:50	15:00	15:10
				15:00	15:10	15:20	15:30	15:40
				15:30	15:40	15:50	16:00	16:10
				16:00	16:10	16:20	16:30	16:40
				16:30	16:40	16:50	17:00	17:10
				17:00	17:10	17:20	17:30	17:40
				17:30	17:40	17:50	18:00	18:10
				18:00	18:10	18:20	18:30	18:40



开幕演讲

今年由华东 PCB 联谊会主办，并由超特公司、罗门哈斯电子材料有限公司、欣兴电子股份有限公司共同赞助的「2006 苏州 PCB 技术信息发展研讨会」于 4/19-21 在苏州国际博览中心 3 楼举行。

在隆重的开幕典礼结束后，接着就是在展览 3 楼举行的开幕演讲(Keynote Speech)，此次开幕演讲特别邀请到华东 PCB 产业知名人士，也是台商赴大陆投资的前辈吴礼淦董事长(沪士电子)为所有与会贵宾探讨当前 PCB 产业与中国投资环境等议题，同时主办单位也邀请了华东 PCB 联谊会会长陈正雄(上海展华电子)为大家作开场引言，陈会长以简单明了的语言为大家介绍吴总裁，让全场内容注入了更多可看性。

下午 Keynote Speech 场次亦特别请到 PCB 产业佼佼者雅新电子(苏州)有限公司卢耀普总经理主讲“整合企业资源，提升竞争能力”议题，主办单位亦邀请到华南 PCB 联谊会会长陈明星(鑫华宝讯电子有限公司)作引言，陈会长也将个人经验作一简单分享，让与会贵宾获益良多。





技术论坛网罗尖端技术 人气火旺

自 4 月 20 日上午开始，为期两天的专业技术论文发表及特别讲座即正式展开，本届有「**Technical Session**」、「**Workshop**」产业市场技术研讨会内容如下：

Technical Session 部份：

1. 4/20 光电产业与 PCB 产业的互利互惠
2. 4/20 柔性板的技术与发展趋势
3. 4/20 软性铜箔基板现况与发展
4. 4/21 近期的 PCB 技术发展趋势
5. 4/21 无铅无卤覆铜基板材料发展
6. 4/21 印刷电路板化学处理绿色制程应用

清溢精密光电
深圳比亚迪科技
松扬电子材料
苏州金像电子
广东生益科技
阿托科技

庞春霖副总
顾志明经理
丘建华总经理
林定皓协理
蔡健伟经理
叶瑞铭经理

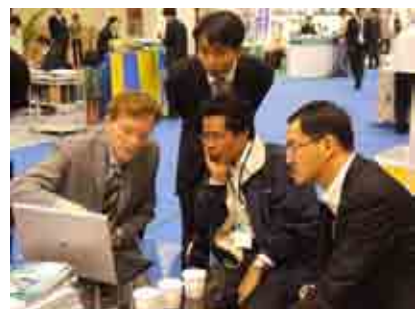
Workshop 部份:

- 1. 4/20 无铅焊接的隐忧
- 2. 4/20 无铅 PCB 之表面处理

台湾电路板协会技术顾问 白蓉生教授
台湾电路板协会技术顾问 白蓉生教授



展览花絮







See you in April 2007